

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 34610

Ref. Expediente N° NC2017/0001225

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 47367 del 04 de Agosto de 2017 la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de registro de esquema de trazado de circuitos integrados, denominada: ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITO INTEGRADO APLICABLE A UNA CELDA SOLAR SENSIBILIZADA POR COLORANTE, con fundamento en el artículo 93 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que el esquema de trazado en estudio no cumplió con los requisitos, específicamente por no cumplir con la definición prevista en el artículo 86 del mismo cuerpo normativo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de Septiembre de 2017 con el N° NC2017/0009258, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la CORPORACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO – CIDET interpuso el recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1 Del concepto de esquema de trazado y circuito integrado.

La recurrente manifiesta que la solicitud corresponde en todos sus aspectos con la definición de un esquema de trazado, según lo dispuesto en el artículo 86 de la Decisión Andina al estimar que “(...) *La función electrónica que realiza el IC del esquema de trazado de circuito integrado de la solicitud es la conversión de radiación, por ejemplo, luz solar en electricidad o energía fotovoltaica (...)*”.

Adicionalmente, la recurrente argumenta que “(...) *el circuito equivalente idealizado muestra claramente que el objeto de la invención dispone de una serie de elementos electrónicos, tanto pasivos como activos, los cuales permiten explicar el funcionamiento electrónico de la celda. El circuito equivalente idealizado presenta una fuente de corriente (I) conectada a un diodo ZD, a su vez también conectado en paralelo a una resistencia shunt (Rsh), conectada esta resistencia shunt (Rsh) con la serie dada por la resistencia (Rs) y una capacitancia (Cs). Por otro lado la resistencia shunt (Rsh), engloba una serie de fugas de corriente que se producen en las zonas periféricas del dispositivo a través de los defectos puntuales que se pueden generar en el proceso de fabricación. Además de influenciar en el contacto entre la capa fotoactiva entre el primer electrodo (1) y el segundo electrodo (3). Así mismo la resistencia en serie (Rs) proviene de la resistencia entre la película fotoactiva y el sustrato. A mayor (Rs) se incrementa la potencia disipada en la junta y menor la tensión a través de la carga. De manera análoga, para una persona versada en el arte (electrónica y/o microelectrónica), es claro que con respecto a una figura presenta de las capas de material de un transistor NMOS integrado (...)*”.



Ref. Expediente N° NC2017/0001225

La recurrente se refiere a la figura 4 y señala lo siguiente: “(...) Debe notarse la relación y enorme similitud con la FIG. 4 del circuito equivalente idealizado del IC de la solicitud de esquema de trazado de circuito integrado presentado por CIDET, en el sentido de los elementos activos y las fuentes controladas de corriente, acogiéndose a lo que se indica en el documento (OMPI/DI/CTG/97/3) en el apartado Aspectos técnicos de los circuitos integrados numeral 10:

(...) los componentes están conectados de manera que el circuito integrado pueda controlar el movimiento de los electrones, es decir de la corriente eléctrica. Los circuitos integrados, al controlar la corriente en sus circuitos, pueden rectificar, amplificar, hacer oscilar o conmutar esa corriente (...) (p.6) (...)” –Subrayado y negrita original del texto-.

2.2 De la diferencia entre un circuito electrónico y un circuito integrado.

La recurrente argumenta que la solicitud corresponde a un circuito integrado y asegura que: “(...) la solicitud de esquema de trazado de circuito integrado del CIDET corresponde a un circuito integrado y no a un circuito electrónico descrito en un PCB por las razones indicadas en el documento Respuesta al oficio n° 2769, notificado en fecha 27 de febrero de 2017, tal como se resumió en el numeral 1 de "ANTECEDENTES" del presente recurso.

Así las cosas, es completamente clara la diferencia entre un circuito electrónico discreto y un circuito integrado y que la solicitud presentada equivale a la definición legal de un circuito integrado.

Adicionalmente, el aspecto no estándar tampoco es una limitación dada por la ley pues se trata de condiciones propias del momento de la investigación y alcances, pues entonces negaríamos la posibilidad de evolución y desarrollo como el indicado en la figura del primer circuito integrado, que se enseña más abajo en el presente memorial. Para el caso del trazado de la solicitud realizada por CIDET, se trata de una investigación que incluye elementos altamente innovadores como las disposiciones de capas semiconductoras (...).” –Subrayado original del texto-.

2.3 De la configuración del circuito integrado.

La recurrente señala que “(...) En lo referente a los encapsulados de los circuitos integrados la función de estos es aislar el circuito de agentes externos, como el polvo o la humedad y en algunos casos lograr la disipación de calor en su funcionamiento normal, el calor debe atravesar el encapsulado.

El encapsulado del circuito integrado de la solicitud de esquema de trazado presentada por CIDET fue desarrollado utilizando vidrio conductivo en las caras superior e inferior del Circuito integrado y masilla epóxica sellando las caras restantes tal cual esta descrita en la solicitud del trazado.

Como referencia, los encapsulados estándar son por ejemplo los DIP (Dual In- Line Package), SIP (Single In- Line Package), ZIP (Zig- Zag In- Line Package) o los PGA (Pin Grid Array), PPGA (Plastic Pin Grid Array) y CPGA (Ceramic Pin Grid Array). Sin embargo, no es un requisito de ley que el encapsulado sea alguno de los estándares de la industria.

Adicionalmente este tipo de encapsulado no debería sorprender a la luz de la definición por ejemplo de los Circuitos híbridos de capa gruesa que se definen como:

‘Circuitos híbridos de capa gruesa (haciendo referencia en la citada fuente a tipos de integrados): se apartan bastante de los circuitos monolíticos. De hecho suelen contener circuitos monolíticos sin cápsula, transistores, diodos, etc. sobre un sustrato dieléctrico, interconectados con pistas conductoras. Las resistencias se depositan por serigrafía y se ajustan haciéndoles cortes con láser. Todo ello se encapsula, en capsulas plásticas o metálicas, dependiendo de la disipación de energía calórica requerida. En muchos casos, la cápsula no está moldeada, sino que simplemente se cubre el circuito con una resina epoxi para protegerlo. En el mercado se encuentran circuitos híbridos para aplicaciones en módulos de radio frecuencia (RF), fuentes de alimentación, circuitos de encendido para automóvil, etc.’ Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado fecha de consulta 12 de Septiembre 2017. -Subrayado original del texto-.

Así las cosas y por las razones expuestas el examinador debe acogerse en su examen al cumplimiento estricto de la ley, sin realizar interpretaciones cargadas de subjetividad y prejuicio técnico que no se encuentre demarcado por la norma, y debe abstenerse de introducir condicionamientos que la ley no trae, como por ejemplo conceptos de fan out, fan in, niveles de tensión de entrada y salida, margen de ruido, tiempo de propagación medio, disipación de potencia, densidad de integración y tipo de encapsulamiento, etc. La lista podría crecer indefinidamente según el gusto o capricho personal de cada examinador (...).’ – Subrayado fuera de texto -

2.4 Del tamaño del circuito integrado.

La recurrente manifiesta que la definición legal de diseño del esquema de trazado no limita el circuito a que deba ser inmensurablemente pequeño y al respecto asegura que “(...) El tamaño de los circuitos integrados no puede ser una limitante a su protección. De nuevo, nótese la imagen del primer circuito integrado de la historia presentado anteriormente, el cual es mucho mayor a muchos de los circuitos integrados actuales. Indicar que el IC debe ser de pocos milímetros o micras, sería negar que los primeros circuitos integrados fueran considerados como tales. – Subrayado fuera de texto -

Bien hace entonces el legislador Andino al no confundir las causas con las consecuencias en la definición de circuito integrado, al no incluir dentro de su definición conceptos como por ejemplo densidad de integración, sino por el contrario considerando solamente los mínimos técnicos que definen un circuito integrado. – Subrayado fuera de texto -

Así, el Artículo 86 de la Decisión Andina en su literal a) señala: “A efectos del presente Título se entenderá por:

a) circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que este destinado a realizar una función electrónica. - Subrayado fuera de texto - (p.20)

Uno de los requisitos mínimos está dado por el principio de integración, (diferente del concepto de densidad de integración), que consiste en que alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material es decir están montados en un sustrato común de material semiconductor, que para el caso de la solicitud presentada por el CIDET se refiere al menos a la primera capa de material de óxido semiconductor poroso (2) que soporta las demás capas y componentes listas en la solicitud cumpliendo la función electrónica indicada (...).’ - Subrayado fuera de texto -



Ref. Expediente N° NC2017/0001225

2.5 De los aspectos técnicos de los circuitos integrados incluidos en el documento OMPI/DI/CTG/97/3.

2.5.1 De la definición de circuito integrado en OMPI/DI/CTG/97/3.

En una primera medida, la recurrente hace alusión al numeral 10 del documento (OMPI/DI/CTG/97/3) y asegura lo siguiente: “(...) *Se entiende por circuito integrado un dispositivo en el que ciertos componentes con funciones eléctricas, tales como transistores y resistencias, están montados en un sustrato común, normalmente una microplaqueta hecha de silicona pura. Esos componentes están conectados de manera que el circuito integrado pueda controlar el movimiento de los electrones, es decir de la corriente eléctrica. Los circuitos integrados, al controlar la corriente en sus circuitos, pueden rectificar, amplificar, hacer oscilar o conmutar esa corriente (...) (p.6)*”. – Negrita y subrayado original del texto -

A continuación, la recurrente realiza una serie de precisiones técnicas sobre lo señalado en el documento en los siguientes términos: “(...) ‘Silicona’ corresponde a una mala traducción. La traducción más correcta en español sería Silicio, que corresponde al elemento químico metaloide, numero atómico 14 y situado en el grupo 14 de la tabla periódica de los elementos de símbolo Si. Adicionalmente, la palabra ‘puro’ no hace referencia al estado en que dicho elemento se encuentra en la naturaleza, sino al proceso en el que el silicio es refinado por medio de técnicas bien establecidas de purificación y crecimiento de cristales, dado que en la fabricación de circuitos integrados en adelante IC (por las siglas en inglés Integrated Circuit) difícilmente se usaría Silicio en estado ‘puro’ natural o incluso totalmente purificado únicamente, pues, y como es claro para una persona medianamente versada en la materia, los semiconductores (incluido el silicio) usados comúnmente en la fabricación de IC pueden ser elementos ‘dopados’, es decir que incluyen impurezas controladas de materiales llamados dopantes.

2.5.2 Del material a partir del que se elaboran los elementos del circuito: microplaquetas.

La recurrente señala lo siguiente: “El término microplaqueta es una palabra compuesta de: micro- 1. (Según la RAE: elem. compos. Significa 'muy pequeño' como en microelectrónica, microscopio.) y plaqueta: que según el diccionario de la real academia de la lengua proviene de la palabra Placa la cual a su vez se define como: ‘6. f. Lámina, plancha o película que se forma o está superpuesta en un objeto’. Debe también recordarse que la palabra película se define según la RAE como 2. ‘f. Capa delgada que se forma sobre algunas cosas o las recubre’. Así las cosas la expresión ‘**una microplaqueta hecha de silicona pura**’ sería entendida por la persona medianamente versada en la materia, como **una placa o capa pequeña de material semiconductor**, donde el término silicio se extiende a distintos tipos de semiconductores (Germanio, Galio o elementos cerca de la llamada escalera metaloide en la tabla periódica), puesto que se está usando una expresión en lenguaje ‘técnico coloquial’, como es la palabra silicio ‘silicona’, que corresponde al semiconductor más estándar en la industria, pero que no es el único tipo de semiconductor posible, ni el único usado en la fabricación de IC, como se explicará más adelante. – Negrita original del texto -

Por lo anterior, el texto no debe ser tomado literalmente, además contiene términos relativos (como por ejemplo la palabra ‘pequeño’) que pueden ser interpretados de manera variable y relativa. En este punto me permito **cuestionar respetuosamente al despacho si ¿todos los circuitos integrados son hechos de silicio?** (...)”. – Negrita y subrayado original del texto -



Ref. Expediente N° NC2017/0001225

La recurrente manifiesta que “(...) Así las cosas, en la solicitud de esquema de trazado de circuito integrado presentada por CIDET se describen las capas que una sobre la otra conforman la placa (portón de material) de material semiconductor, particularmente una primera capa de material de óxido semiconductor poroso (2). Es claro entonces que la presente invención sí comprende una placa o capa pequeña de material semiconductor que soporta diferentes elementos con una función eléctrica, por ejemplo, capa de sustancia orgánica (6) y la solución electrolítica (7), entre otros componentes. Estas capas están entonces, en un sustrato común, como se puede evidenciar en la FIG. 1 cumpliendo con el numeral 10 del documento (OMPI/DI/CTG/97/3) (...)”.

2.5.3 De la representación gráfica y la estructura del circuito integrado.

La recurrente manifiesta que la estructura de la solicitud corresponde a un diseño o plan que cumple con la definición propia del esquema de trazado y al respecto sostiene que: “(...) Por otro lado, llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre la descripción de la solicitud de esquema de trazado integrado realizado por CIDET, donde explica en texto y también de manera gráfica la disposición tridimensional del circuito integrado y particularmente de manera gráfica de la FIG. 1 a la FIG. 3, cumpliendo de esta manera con la especificación de la organización o estructura de los elementos del trazado de circuito integrado, conforme a un diseño o plan.

Vale la pena resaltar en ese punto que la protección de esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados resulta obligatoria en todos los países miembros de la OMC (Organización Mundial de Comercio) a través de la Sección 6, artículo 35, de los artículos de la ADPIC (TRIPS en inglés). De esta forma, la legislación Colombiana se ajusta a lo establecido en los acuerdos ADPIC. – Subrayado fuera de texto -

Así las cosas, como demostración adicional de que la presente solicitud de esquema de trazado de circuito integrado cumple incluso con la normativa internacional, consideremos el Reglamento español de ejecución de la ley 11/1988¹ de las topografías de productos semiconductores (termino equivalente, según los Art. 35 a 38 de los ADPIC, a ‘Esquema de Trazado de Circuito Integrado’ como se ha manifestado anteriormente) indica la manera de representar las topografías, la cual se puede ver en la página Web <http://www.wipo.int/wipolex/f/textjsp?file id=126567>, donde se establece:

Art. 5 (1) La representación gráfica o identificación está compuesta, de tal manera que revelan la estructura tridimensional dibujos, fotografía o ambas cosas, de: (a) esquema de fabricación del producto semiconductor (b) las máscaras o parte de las máscaras para la fabricación del producto semiconductor, o (c) las capas del producto semiconductor. - Subrayado fuera de texto -

En la presente solicitud de esquema de trazado de circuito integrado presentada por CIDET, se especifica la estructura tridimensional, dibujos, fotografía y adicionalmente que especifican las capas del producto semiconductor, como se indicó de igual manera en el literal b (...)” –Subrayado original del texto-.

2.6 De los requisitos que tiene que satisfacer un esquema de trazado y las opciones para diseñar su estructura.

La recurrente hace referencia al numeral 14 del documento (OMPI/DI/CTG/97/3) y asegura lo siguiente: “(...) Hay otros requisitos que determinan la estructura física de un circuito integrado dentro de las limitaciones mencionadas antes. Por ejemplo, para lograr mayor densidad en un circuito integrado se podría optar por un esquema de

trazado más compacto. **Sin embargo, como ciertas combinaciones de transistores pueden causar interferencias indeseables, podría resultar preferible optar por otra estructura para el circuito, aunque no fuese el mejor desde el punto de vista de la densidad.** En este sentido, conviene distinguir entre la estructura física de un circuito integrado, que está determinada por su esquema de trazado, y los requisitos que determinan esa estructura física, que dependerán de las funciones que habrá de cumplir el circuito integrado. (Subrayado fuera de la cita) (p.7) (...). - Negrita y subrayado original del texto -

A continuación, la recurrente argumenta que “(...) **estos otros requisitos** son de estructura física y no son requisitos de condición necesaria en la definición legal de circuito integrado, es decir no son esenciales para la definición de circuito integrado como la entendería la persona medianamente versada en la materia. Así las cosas, los requisitos de estructura a los que se refiere el documento (OMPI/DI/CTG/97/3) se tratan de consecuencias de los circuitos integrados y no de causas de los circuitos integrados; es decir por ejemplo que se logran mayores niveles de densidad como causa de la tecnología de los circuitos integrados, pero estas densidades de integración no trazan un límite de la definición de circuito integrado, puesto que dicha densidad depende de la función que habrá de cumplir y puede ser menor o mayor dependiendo de las aplicaciones. Esto se traduce en el caso de CIDET, en que el tamaño cumple una función esencial de recibir luz natural. – Negrita y subrayado original del texto.

De incluir los requisitos estructurales o consecuencias estructurales (por ejemplo, densidad de integración) en la lista de condiciones para definir un circuito integrado, dicha condición impondría una carga excesiva e incierta al solicitante, toda vez que estas condiciones son inmensamente variables en el tiempo, según las diversas tecnologías de fabricación de circuitos integrados y en la funcionalidad específica desarrollada para un circuito particular, por ejemplo con un baja densidad de componentes o en el que se requiera un tamaño considerable. –Subrayado fuera de texto -

Profundizando en el anterior concepto, esta condición resultaría limitante debido a las circunstancias temporales e históricas de un determinado momento, por ejemplo las densidades de integración a la fecha de hoy de los circuitos integrado es mayor a las densidades de integración de los circuitos integrados de años anteriores y en muchos caso menor a las que se logran en años venideros. Así por ejemplo si se incluyera como requisito de la definición la densidad de integración, estaríamos negando los hechos técnicos e históricos entrando en contradicción lógica al negar protección, por ejemplo, de los primeros circuitos integrados de la historia (de hace algunas pocas décadas), argumentado que estos tenían poquísimos elementos o no tenían un tamaño pequeño para ser considerados circuitos integrados protegibles (...). –Subrayado fuera de texto -

2.7 De los elementos requeridos para definir el esquema de trazado.

La recurrente argumenta que la solicitud cumple con el numeral 10 del documento (OMPI/DI/CTG/97/3) y asegura que “(...) en este circuito equivalente se da cuenta de la fuente de corriente I, en particular controlada por la intensidad de radiación incidente, la cual puede conmutar, oscilar o incluso amplificarse según la radiación incidente, cumpliendo de esta forma con el requerimiento de la definición del documento (OMPI/DI/CTG/97/3) en el apartado **aspectos técnicos de los circuitos integrados numeral 10**, pues es innegable que el circuito integrado de la solicitud **puede controlar el movimiento de los electrones**, es decir de la corriente eléctrica. **Los circuitos integrados, al controlar la corriente en sus circuitos, pueden rectificar, amplificar, hacer oscilar o conmutar esa corriente**” - Subrayado fuera de la cita -

Ref. Expediente N° NC2017/0001225

De esta forma, queda demostrado que la solicitud cumple a cabalidad con las especificaciones de (OMPI/DI/CTG/97/3)) en el apartado: Aspectos técnicos de los circuitos integrados numeral 10, pues contiene una placa o capa de material semiconductor en el que están soportados qué componentes con funciones eléctricas donde el circuito controla la corriente (...)” – Subrayado y negrita original del texto -

Adicionalmente, respecto del contenido de los numerales 38 y 39 del documento (OMPI/DI/CTG/97/3) la recurrente señala: “(...) Por favor nótese que la solicitud de esquema de trazado de circuito integrado presentada por CIDET tiene al menos dos capas de material semiconductor: (a) una primera capa de material de óxido semiconductor poroso (2) y (c) una segunda capa de material de óxido semiconductor poroso (5), depositados junto con un conjunto de componentes descritos en las capas sucesivas, y que en su representación circuital equivalente cumple funciones de fuente controlada de corriente, condensador, resistencia, etc. (ver FIG. 3 (...)).” -Subrayado y negrita original del texto -

Respecto al numeral 40 del documento (OMPI/DI/CTG/97/3), la recurrente manifiesta que “(...) Por favor nótese que la solicitud de esquema de trazado de circuito integrado presentada por CIDET tiene material semiconductor en por lo menos una primera capa de material de óxido semiconductor poroso (2) y presentan un efecto de sinergia funcional entre las partes que conforman el esquema de trazado de circuito integrado, superando la simple unión mecánica al estar inseparablemente formados en un material semiconductor, siendo necesaria la interacción de los electrones en cada una de las partes que lo constituyen formando de esta manera un solo cuerpo, como como se presenta haciendo referencia de la FIG. 1 a la FIG. 3 (...)”. - Subrayado y negrita original del texto -

Además, respecto al numeral 41 del documento (OMPI/DI/CTG/97/3), la recurrente señala que “(...) Por favor nótese que la solicitud de esquema de trazado de circuito integrado presentada por CIDET tiene al menos dos capas de material semiconductor una primera capa de material de óxido semiconductor poroso (2) y una segunda capa de material de óxido semiconductor poroso (5) depositado junto con conjunto de componentes.

Se deduce de la legislación del Reino Unido la posibilidad de que se tengan otras capas que no sean de óxido semiconductor siempre y cuando se tenga al menos una capa esté compuesta de material semiconductor. Condición que se cumple a cabalidad en la solicitud de esquema de trazado de circuito integrado presentada por CIDET (...). – Negrita y subrayado original del texto -

Por otro lado, frente al numeral 42 del documento (OMPI/DI/CTG/97/3) la recurrente asegura que “(...) la solicitud de esquema de trazado de circuito integrado presentada por CIDET tiene material semiconductor (a) una primera capa de material de óxido semiconductor poroso (2), con capas suplementarias como, por ejemplo, capa de sustancia orgánica (6), la cual facilita la conducción de los electrones al sensibilizar el IC de la celda solar (...).” – Negrita y subrayado original del texto -

2.8 De los materiales de los que está constituido el producto semiconductor según el documento OMPI/DI/CTG/97/3.

Respecto de los numerales 16 y 17 del documento (OMPI/DI/CTG/97/3) la recurrente argumenta lo siguiente: “(...) Se deriva de estos apartados que si bien es cierto que la actualidad los semiconductores de silicio son estándar en la industria, no son el único

Resolución N° 34610

Ref. Expediente N° NC2017/0001225

material para la fabricación de IC y los listados en apartados 16 y 17 del documento (OMPI/DI/CTG/97/3) no deben ser considerados como taxativos o una lista exhaustiva de materiales Semiconductores.

A continuación, la recurrente reitera lo siguiente: *“De esta manera, si el Examinador limita el circuito integrado del trazado a un solo tipo de material semiconductor, como por ejemplo al óxido de silicio, entonces está limitando las futuras generaciones de IC que pueden ser objeto de protección, sin mencionar que dicho requisito de la especificidad de material no se encuentra contenido ni en las leyes nacionales ni en las internacionales relacionadas con el objeto de la protección.*

Igualmente debe notarse que según lo especificado el numeral 17 del documento (OMPI/DI/CTG/97/3), se permite dentro de los IC componentes de circuitos integrados hechos con otros materiales, como material sensible a la luz, de manera que la opinión de la examinadora en el oficio n° 2769, notificado en fecha 27 de febrero de 2017, donde indica que ‘el objeto de esta solicitud es un circuito electrónico que se compone de diversos componentes electrónicos y químicos (un semiconductor formado entre un ánodo foto sensible y un electrolito)’ debe tomarse en positivo como una aceptación del cumplimiento de toda la normativa sobre el trazado de circuitos integrados, y no en sentido negativo al decir que NO constituye un esquema de trazado por contener elementos fotosensibles (...).”

Finalmente, la recurrente considera que *“(...) la presente solicitud cumple a cabalidad con todos los requisitos de registro, y por lo tanto, con base en los argumentos aquí presentados se debe revocar la resolución 47367 del 3 agosto de 2017, y en su lugar se debe continuar con el trámite administrativo de concesión del presente trazado de circuito integrado (...).”*

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de apelación interpuesto en los siguientes términos

3.1 De la actuación administrativa.

Verificada la actuación administrativa desplegada en el caso bajo revisión se advierte que mediante Resolución N° 47367 del 04 de agosto de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de registro de esquema de trazado de circuitos integrados, al considerar que la materia incorporada en la solicitud no se ajustaba al concepto de circuito integrado ni al de esquema de trazado, previsto en el artículo 86 de la Decisión 486.

La decisión se basó en el requerimiento formulado por la Dirección de Nuevas Creaciones en virtud del artículo 93 de la Decisión 486, comunicado mediante el Oficio N° 2769 notificado el 27 de febrero de 2017, por medio del cual se requirió a la interesada con el fin de que subsanara las objeciones en relación con los requisitos de presentación de un esquema de trazado de circuito integrado, la ausencia de una representación gráfica del esquema de trazado, el poder otorgado al abogado y la documentación necesaria para la transferencia de la titularidad de la solicitud, tal y como lo dispone el artículo 92 del mismo cuerpo normativo. Asimismo, se comunicaron las deficiencias de la solicitud de registro en virtud de lo dispuesto en por el artículo 86 de la Decisión 486.

La solicitante presentó nuevas figuras y argumentó que correspondían a representaciones gráficas de un esquema de trazado. Asimismo, allegó el poder y el formato de cesión respectivos como parte de la respuesta al requerimiento formulado por

Resolución N° 34610

Ref. Expediente N° NC2017/0001225

el Despacho. De otra parte, en la respuesta argumentó que la solicitud cumplía con lo dispuesto en el artículo 86 de la Decisión 486.

La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció de forma definitiva sobre la registrabilidad de la solicitud a través de la Resolución N° 47367 del 04 de Agosto de 2017 y decidió declarar abandonada la solicitud en virtud de las prescripciones del artículo 93 de la Decisión 486, al considerar que a pesar de la respuesta aportada no se podían dar por superadas las objeciones en virtud del artículo 86 de la Decisión 486 porque la solicitud no constituía un esquema de trazado de circuito integrado. Sin embargo, en la precitada Resolución no se hizo mención alguna respecto de la pertinencia y/o aceptación de las representaciones gráficas del esquema de trazado, del poder y del documento de cesión allegados.

En consideración a lo anterior, el Despacho del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resuelve el recurso de apelación interpuesto en el presente caso en atención a las disposiciones normativas contempladas en el capítulo quinto, Título I de la Circular Única y del artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que establece lo siguiente: *“Decisión de los recursos. Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso.*

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.

Así, de la revisión del procedimiento adelantado en el presente caso este Despacho encuentra lo siguiente:

3.2 Del concepto de esquema de trazado y circuito integrado. Análisis de las disposiciones normativas citadas como referencia.

3.2.1 Decisión 486 de 2000.

El marco normativo de la Comunidad Andina correspondiente a la Decisión 486 de 2000 incorporó los conceptos de circuito integrado y esquema de trazado – topografía – dentro de la definición que se presenta en el artículo 86. Esta definición tiene su origen en el Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, tratado al que remite el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio – ADPIC – que en su artículo 35 presenta un marco normativo común sobre el reconocimiento de los derechos que confiere la protección otorgada a los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados.

Artículo 86. *“A efectos del presente Título se entenderá por:*

a) circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una función electrónica;

b) esquema de trazado: la disposición tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado”.

De manera que este es el marco normativo aplicable al caso en concreto de la solicitud de registro de circuitos integrados y esquemas de trazado, identificada con el radicado



Resolución N° 34610

Ref. Expediente N° NC2017/0001225

bajo el N° NC2017/0001225, frente a la que la recurrente impugna la decisión de abandono.

3.2.2 Ley española 11 de 1988. Protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.

Ahora bien, dado que en el cuerpo del recurso la recurrente cita como referencia las disposiciones normativas de la Ley española sobre topografías de los productos semiconductores - Ley 11 de 1988 -, transcrita a continuación:

“Artículo 1. Definiciones.

A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

1. Producto semiconductor, la forma final o intermedia de cualquier producto:

- a) constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor,*
- b) que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, aislantes o semiconductores, dispuestas en función de una estructura tridimensional predeterminada, y*
- c) destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con otras funciones, una función electrónica.*

2. Topografía de un producto semiconductor, una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o codificadas:

- a) que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor,*
- b) en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación.*

3. Explotación comercial, la venta, el alquiler, el arrendamiento financiero o cualquier otro método de distribución comercial, o una oferta con dichos fines.

A los efectos de la anterior definición, no se incluirá la explotación que se realice en condiciones de confidencialidad, siempre que no se produzca distribución a terceros. No obstante, sí se incluirá la explotación que se realice en condiciones de confidencialidad cuando éstas vengan exigidas por razones de seguridad en relación a aplicaciones militares”.

Este Despacho encuentra pertinente señalar que los conceptos desarrollados en este cuerpo normativo devienen de la definición contemplada en la Directiva europea 87/54/CEE del 16 de Diciembre de 1986, sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.

Sin embargo, estas disposiciones no son aplicables al caso concreto de las solicitudes de registro de circuitos integrados y de esquemas de trazado que se presentan ante la Oficina competente en Colombia, porque el régimen de propiedad industrial aplicable al caso es el que corresponde a la Decisión 486 de la Comunidad Andina; de manera que el argumento de la recurrente en este sentido no resulta procedente en la medida que el artículo 86 de la Decisión Andina 486 acoge la definición de circuito integrado y esquema de trazado desarrollada en el Convenio de Washington.

En punto de la discusión que se suscita frente al marco normativo aplicable, es del caso señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina - TJCA- ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de la “Preeminencia del

Resolución N° 34610

Ref. Expediente N° NC2017/0001225

Derecho Comunitario Andino” soportándolo en otros principios como son: el de eficacia directa, aplicabilidad inmediata y autonomía del ordenamiento jurídico Andino, como se concluye de las interpretaciones prejudiciales emitidas por el alto tribunal:

“(…) dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco se ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional”¹.

En cuanto tiene que ver con el principio de autonomía, el TJCA, ha señalado que *“(…) le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico”².*

En este sentido, la decisión definitiva sobre si el objeto de la solicitud constituye un esquema de trazado conforme a la definición legal, está determinada por el tenor del Ordenamiento Comunitario Andino. Cabe indicar que imperan, en materia de propiedad industrial, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento registrar la solicitud de esquema de trazado de circuitos integrados, en virtud del análisis propio de originalidad, el caso particular y normatividad aplicable, por lo que esta Oficina no comparte la valoración y referencia presentada por la recurrente en relación con la definición comprendida en la Ley española de 1988 y en consecuencia, no se halla mérito en lo expuesto.

3.2.4 De la aplicación del concepto en Colombia

La adecuación de la materia descrita en la solicitud de registro de esquema de trazado y de circuitos integrados a la definición legal en virtud de la evolución y dinámica de la innovación en este campo técnico, permite señalar que el circuito integrado corresponde a un dispositivo en el que ciertos componentes con funciones eléctricas están integrados sobre un sustrato común inseparable e indivisible, normalmente denominado una microplaqueta.

En cuanto tiene que ver con su funcionalidad, los circuitos integrados pueden operar como memorias o procesadores que manipulan datos. Así, en la fabricación de circuitos integrados se pueden utilizar procedimientos fotoquímicos para generar distintas capas en ambientes de baja o nula contaminación. La producción generalmente se hace en masa y las capas se componen de un material semiconductor, un material aislante y/o un material conductor, para los que se utilizan sustancias químicas como el silicio o el germanio, al igual que compuestos químicos como arseniuro de galio, fosfato de galio y Antimoniuro de indio.

Ahora bien, la finalidad de un circuito integrado consiste en lograr una mayor velocidad de procesamiento o una mayor velocidad de corriente eléctrica, lo cual se consigue por medio de la distribución y constitución de las capas de material semiconductor agrupadas dentro de la microplaqueta, por lo que una PCB (Printed Circuit Board) no se adecúa a la definición de circuito integrado, en la medida que se trata de varios componentes electrónicos interconectados y soldados sobre una placa compuesta de pistas de cobre, es decir, una PCB no se conforma de una sola pieza única de material indivisible.

¹ Proceso 43-IP-2014. M.P. Leonor Perdomo Perdomo. P. 9.

² Ídem Proceso 43-IP-2014. M.P. Leonor Perdomo Perdomo. P. 9.



Resolución N° 34610

Ref. Expediente N° NC2017/0001225

Por otro lado, un esquema de trazado de circuito integrado es llamado también medio de enmascaramiento o topografía de circuito. Un esquema de trazado corresponde a una serie de imágenes que representan gráficamente el diseño o la forma bidimensional de las capas de los elementos semiconductor, metálico y/o aislante presente o no en una microplaqueta, tal y como lo establece la definición prevista en el Ordenamiento Comunitario Andino.

Así, en la definición de un circuito integrado, se contemplan todos aquellos productos destinados a realizar una función electrónica y cuyos elementos están contenidos dentro de una misma estructura tridimensional y uno de estos elementos corresponde a un elemento activo, es decir, entendido como un elemento semiconductor que en este caso corresponde a una de las capas de material del circuito integrado.

Por consiguiente, los conceptos anteriormente descritos frente a la operatividad del circuito integrado y al esquema de trazado de circuito integrado se adecúan a las disposiciones normativas de la Decisión 486, dado que presentan un circuito integrado que contiene una pieza de sustrato común inseparable, es decir una estructura tridimensional que contiene una serie de capas de material semiconductor (componentes activos) destinados a cumplir una función electrónica en particular, tal y como se aprecia en la figura 5 de la solicitud de esquema de trazado tramitada en el presente expediente.

Adicionalmente, la materia descrita en la solicitud se adecúa a la definición del artículo 86 de la Decisión Andina porque se refiere a la representación gráfica de las capas de material semiconductor y del material aislante y/o metálico del circuito integrado, representado de manera tridimensional en la estructura del circuito, así como de las interconexiones entre los diferentes elementos y/o capas de su estructura, tal y como se aprecia en las figuras 1 a 3 de la solicitud de esquema de trazado tramitada en el presente expediente.

De acuerdo a la definición ya detallada, a la comparación anterior y frente al argumento del recurrente según el cual la solicitud reclamada corresponde en todos sus aspectos con la definición prevista en el artículo 86 de la Decisión Andina, cabe aclarar que el circuito descrito en la solicitud efectivamente cumple una función electrónica, la cual consiste en la conversión fotovoltaica para generar energía eléctrica. Por otro lado, la celda consta de una serie de capas cuyo circuito equivalente corresponde a una serie de elementos pasivos, tales como resistencias y capacitancias, así como de un elemento activo que corresponde a un diodo, los cuales pueden controlar el movimiento de los electrones - corriente eléctrica - dentro de la celda, por lo que este Despacho entiende superada la objeción formulada en virtud del artículo 93 de la Decisión 486.

3.3 De la diferencia entre un circuito electrónico y un circuito integrado.

De acuerdo con el argumento de la recurrente según el cual, la presente solicitud corresponde a un circuito integrado y no a una placa de circuito impreso (PCB), resulta del caso aclarar que en efecto la solicitud es un circuito de una sola pieza encapsulada de material en un sustrato común inseparable e indivisible, y no se trata de una serie de componentes electrónicos discretos, soldados en una placa conductora, tal como ocurre en una PCB, por lo que la presente solicitud cumple con la definición legal de circuito integrado y por lo tanto, la objeción inicialmente trasladada se entiende superada.

3.4 Configuración del circuito integrado.

Frente al argumento de la recurrente en relación con el hecho de que la Oficina debe abstenerse de introducir condicionamientos en la aplicación de la ley, específicamente en lo que concierne a la aplicación de conceptos como: fan out, fan in, niveles de tensión de entrada y salida, margen de ruido, tiempo medio de propagación, disipación de

Resolución N° 34610

Ref. Expediente N° NC2017/0001225

potencia, densidad de integración y tipo de encapsulamiento, etc., resulta conveniente aclarar que estos conceptos no son generales para todos los circuitos integrados y que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 86 de la Decisión 486, los parámetros transcritos no son restrictivos para el registro y evaluación de la originalidad de un esquema de trazado de circuito integrado, por lo que para la Oficina se entiende superada esta objeción inicialmente planteada.

3.5 Del tamaño del circuito integrado.

Respecto de los argumentos de la recurrente según los cuales, el circuito integrado presentado en un esquema de trazado no se limita a ser inmensurablemente pequeño, cabe aclarar que le asiste razón y resulta improcedente la objeción inicialmente formulada en el numeral 3.2 de la Resolución N° 47367 del 04 de agosto de 2017, dado que en virtud de las prescripciones normativas del artículo 86 de la Decisión Andina no existen restricciones frente al tamaño y por lo tanto, no es dable al Despacho imponer una limitación en este sentido, para definir los elementos asociados a un esquema de trazado como topografía del circuito integrado y por lo tanto, el principio de integración mencionado por la recurrente, corresponde a la integración de todos los componentes del circuito integrado en una sola pieza de material y no se debe asociar al tamaño del mismo. En consecuencia, este Despacho entiende superada la objeción inicialmente planteada en la Resolución impugnada.

3.6 De los aspectos técnicos de los circuitos integrados en el documento OMPI/DI/CTG/97/3.

3.6.1 De la definición de circuito integrado.

Respecto a los argumentos de la recurrente por referencia al numeral 10 del documento (OMPI/DI/CTG/97/3), cabe aclarar que la presente solicitud cumple las características desarrolladas en este numeral, toda vez que la solicitud corresponde a una placa de material con capas semiconductoras, la cual cumple una función eléctrica en particular, que en este caso es la conversión de energía solar a energía eléctrica, lo cual implica controlar el movimiento de los electrones del flujo de corriente eléctrica generada.

Adicionalmente, cabe recalcar que un circuito integrado debe estar fabricado de un material semiconductor en específico, el cual no es exclusivamente silicio, sino de otros materiales semiconductores y aleaciones del mismo, tal y como lo describe la presente solicitud, superando así esta objeción respecto a este numeral 10.

En el presente caso, el objeto evaluado dentro del alcance de la solicitud de esquema de trazado de circuito integrado se circunscribe a lo que se menciona en el capítulo descriptivo de la solicitud y en las figuras 1 a 3, en los siguientes términos:

De conformidad con la figura 3, las capas de la celda solar sensibilizada por colorante comprenden:

- (a) una primera capa de material de óxido semiconductor poroso (2) depositado en una de las superficies del primer electrodo (1);
- (b) una capa de un catalizador (4) que recubre el segundo electrodo (3);
- (c) una segunda capa de material de óxido semiconductor poroso (5) depositado en una de las superficies del segundo electrodo (3) recubierto de un catalizador (4);
- (d) capa de sustancia orgánica (6) que recubre y es absorbida por la primera capa de material de óxido semiconductor poroso (2) y la segunda capa de material de óxido semiconductor poroso (5);



Resolución N° 34610

Ref. Expediente N° NC2017/0001225

(e) una solución electrolítica (7) que penetra la primera capa de material de óxido semiconductor poroso (2) y la segunda capa de material de óxido semiconductor poroso (5) y llena el espacio entre la primera capa de material de óxido semiconductor poroso (2) y la segunda capa de material de óxido semiconductor poroso (5);
(f) un sello (8) que une el borde del primer electrodo (1) con el borde del segundo electrodo (3) conteniendo la primera capa de material de óxido semiconductor poroso (2), la segunda capa de material de óxido semiconductor poroso (5), la sustancia orgánica (6), y la solución electrolítica (7).

3.6.2 Del material a partir del que se elaboran los elementos del circuito.

De acuerdo al argumento de la recurrente que menciona nuevamente que la solicitud de esquema de trazado describe las capas que lo conforman y que están dispuestas sobre una placa, resulta conveniente indicar nuevamente que la celda consta de una serie de capas de material semiconductor de conformidad con lo indicado en la figura 3, cuyo circuito equivalente corresponde a una serie de elementos pasivos, tales como resistencias y capacitancias, así como de un elemento activo que corresponde a un diodo dentro de la celda, tal como se evidencia en la figura 4 y todos estos elementos son agrupados dentro de una placa, por lo que se entiende superada esta objeción respecto al artículo 86 de la Decisión Andina.

3.6.3 De la representación gráfica y la estructura del circuito integrado.

De acuerdo a los argumentos de la recurrente según el cual afirma que la estructura de la solicitud corresponde a un diseño o plan que cumple con la definición de esquema de trazado, es pertinente aclarar que en la descripción de la solicitud y en los dibujos allegados se evidencia en primera medida que la solicitud revela una estructura tridimensional compuesta de dos capas de óxido semiconductor poroso y un máscara de metalización, tal como se evidencia en las figuras 1 a 3 de la solicitud, lo cual cumple con el requisito de representaciones gráficas que deben ser allegadas dentro de una solicitud de esquema de trazado de circuito integrado, además que corresponden a una representación de la topografía del circuito integrado, superando así este requisito exigido por la entidad.

Por otra parte, respecto a la comparación realizada con el Reglamento español de ejecución de la ley 11/19881 de las topografías de productos semiconductores, cabe aclarar que el Honorable Consejo de Estado ha señalado lo siguiente en sentencia proferida el 4 de julio 2013³, acogiendo las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad incluídas en la interpretación prejudicial en el marco del proceso 85-IP-2011. En efecto, el Honorable Consejo señaló lo siguiente: *“Finalmente, respecto al otorgamiento de patentes por parte de las Oficinas Americana y Europea de Patentes, encuentra la Sala que ello no tiene incidencia en la decisión que deba tomar la Autoridad Nacional, ya que los países miembros de la Comunidad Andina adoptaron un sistema de patentes autónomo e independiente que solo se subsume a la normatividad comunitaria”*

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el citado proceso 85-IP-2011, manifestó lo siguiente: (...) El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344, denominado «De las Patentes de Invención», regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

³ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Ref: Expediente núm. 2006-00131-00. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Actora: HOECHST SCHERING AGREVO GMBH.

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad⁴. De esta manera, cada país u oficina es autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, modelo de utilidad o esquema de trazado de circuitos integrados, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad y casos particulares.

3.7 De los requisitos que tiene que satisfacer un esquema de trazado y las opciones para diseñar su estructura

Respecto del argumento de la recurrente en cuanto a que la solicitud cumple los requisitos opcionales de la estructura física de un circuito integrado definido en el numeral 14, este Despacho encuentra que le asiste razón al afirmar que una solicitud de esquema de trazado de circuito integrado no está limitada por características estructurales tales como el tamaño del circuito o la densidad de integración, sino que por el contrario, la característica estructural que debe tener un circuito integrado es la encapsulación de todas las capas que lo componen en una sola pieza de material o microplaqueta, como ocurre en el circuito descrito en la presente solicitud, por lo que las objeciones relativas al tamaño y a la limitación en la densidad de integración de la microplaqueta, no son condicionantes para definir si un esquema de trazado corresponde a uno de un circuito integrado o no, por lo que este Despacho reitera que las objeciones inicialmente formuladas, se deben dar por superadas.

3.8 De los elementos requeridos para el esquema de trazado.

Frente al argumento del recurrente según el cual, la solicitud reclamada cumple con los numerales 38, 39, 41 y 42 del documento OMPI/DI/CTG/97/3, es preciso mencionar que la solicitud efectivamente especifica dos capas de material semiconductor que corresponden a dos capas de material de óxido semiconductor poroso, las cuales se agrupan dentro una sola placa o microplaqueta y cuyo circuito equivalente, está destinado a cumplir una función electrónica en particular que en este caso corresponde a la conversión de energía solar a energía eléctrica; de manera que cumple con las definiciones citadas previamente.

Por otra parte, respecto al argumento de la recurrente según la cual la solicitud cumple con el numeral 40 del documento OMPI/DI/CTG/97/3, cabe reiterar que la solicitud se basa en una sola pieza de material que contiene dos capas semiconductoras que forman un circuito equivalente inseparable a partir de estas capas, el cual corresponde al circuito equivalente con un diodo, resistencias y una capacitancia tal como se describe en la solicitud, por lo que cumple con lo señalado en el precitado numeral y se da por superada la objeción inicialmente formulada en la Resolución N° 47367 del 04 de agosto de 2017,

⁴ Proceso 85-IP-2011.



Resolución N° 34610

Ref. Expediente N° NC2017/0001225

por medio de la cual se declaró el abandono de la solicitud de esquema de trazado de circuito integrado.

3.9 De los materiales de los que está constituido el producto semiconductor

Frente al argumento de la recurrente según el cual, una solicitud de esquema de trazado no solamente corresponde al de un circuito integrado fabricado a partir de silicio, este Despacho advierte que le asiste razón dado que un circuito integrado tal y como se define en el apartado 3.2.4 de esta Resolución está fabricado a partir de elementos semiconductores que incluyen sustancias químicas como el silicio o el Germanio, al igual que compuestos químicos como arseniuro de Galio, Fosfato de galio y Antimoniuro de indio, por lo cual una solicitud de esquema de trazado no puede limitarse a circuitos integrados fabricados a partir de silicio, sino que puede estar constituido de una serie de capas de un material semiconductor con la finalidad de realizar una función electrónica, tal como ocurre en el presente caso, donde se mencionan dos capas de material semiconductor; con lo cual se cumple con la definición de los materiales que deben aparecer dentro de la definición integral de un circuito integrado y por tanto, de una solicitud de esquema de trazado.

En consecuencia, la solicitud y figuras presentadas se adecuan a la definición prevista en el artículo 86 de la Decisión 486 y además comprende los elementos indicados en los artículos 89, 90 y 91, por lo que este Despacho entiende superadas las objeciones inicialmente planteadas.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, ordenar la publicación del esquema de trazado descrito y representado en las figuras allegadas con el fin de disponerlo a terceros para que puedan tener la oportunidad de oponerse respecto al esquema reclamado si es del caso.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, las figuras correspondientes a la solicitud de esquema de trazado de circuito integrado en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0001225 del 26 de mayo de 2017, cumplen con los requisitos de que tratan los artículos 86 y 87 de la Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente dar continuidad a la etapa procesal correspondiente.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 47367 del 04 de agosto de 2017, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de registro de esquema de trazado de circuito integrado.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar a publicación la solicitud de esquema de trazado de circuito integrado.



Resolución N° 34610

Ref. Expediente N° NC2017/0001225

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a CORPORACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO –CIDET, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotado el recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 8 de agosto de 2019



Iván Mauricio Pinzón Jiménez
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

